

江苏纳沛斯半导体有限公司晶圆片级芯片封装项目(一期项目)

废水、废气环保“三同时”验收会专家意见

2018年4月8日，江苏纳沛斯半导体有限公司主持召开了江苏纳沛斯半导体有限公司晶圆片级芯片封装项目(一期项目)环保“三同时”验收专家评审会；与会人员及专家审阅验收材料，现场查勘后，形成如下专家意见：

1. 根据江苏雁蓝检测科技有限公司出具的竣工环保验收监测报告【(2018)环检(综)字第(S0027)号】，废水总排口各项污染物达标，有组织废气和无组织废气中各项指标排放浓度均符合相关标准要求，污染物总量满足批复要求。

2. 对照项目环评、变动影响分析和验收监测报告，核实一期项目工艺流程、产污环节及三废处理设施，废水、废气源强较低，验收监测报告中相关环保设施的处置效率未能验证，企业应在后期生产中确保达标排放，在条件适合的情况下验证环保设施的处置效率。

3. 企业须加强废气污染治理设施的日常管理，尤其须关注涉重废水的分质处理，严防跑冒滴漏，关注氰化氢气体的破氰和吸附，确保各项污染物稳定达标。

4. 企业应按照应急预案的各项要求定期组织应急演练。

5. 按照环评批复要求，尽快对废水在线监控设备进行比对验收。

专家组：

董蕊 孙 涛 李 涛

2018年4月8日